

行业及产业
电子

NVIDIA 推动供应商加速 MLCP 产业化落地

——电子行业周报（2025/9/15-9/19）

强于大市

一年内行业指数与沪深 300 指数对比走势：



资料来源：聚源数据，爱建证券研究所

相关研究

《电子行业周报：苹果发布 iPhone 17 系列手机》2025-09-16

《电子行业周报：微软积极部署空芯光纤应用》2025-09-10

《电子行业周报：NVIDIA 推出 Jetson AGX Thor 超级电脑》2025-09-02

《电子行业周报：华虹半导体筹划收购华力微控股权》2025-08-25

《电子行业周报：Amazfit 产业链迎来业绩拐点》2025-08-20

证券分析师

许亮
S0820525010002
0755-83562506
xuliang@ajzq.com

联系人

朱俊宇
S0820125040021
021-32229888-25520
zhujunyu@ajzq.com

投资要点：

- **半导体设备领涨电子行业。**本周 SW 电子行业指数(+2.96%)，涨跌幅排名 3/31 位，沪深 300 指数(-0.44%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭(+3.51%)，电力设备(+3.07%)，电子(+2.96%)，汽车(+2.95%)，机械设备(+2.23%)，涨跌幅后五分别为：银行(-4.21%)，有色金属(-4.02%)，非银金融(-3.66%)，钢铁(-2.95%)，农林牧渔(-2.70%)。本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：半导体设备 (+9.98%)，光学元件 (+9.08%)，集成电路制造 (+5.63%)；涨跌幅后三分别是：数字芯片设计 (-0.18%)，面板 (+0.22%)，其他电子 III (+0.74%)。
- **NVIDIA 要求供应商加速 MLCP 液冷技术研发。**2025 年 9 月中国台湾《经济日报》报道，因英伟达 AI 新平台 Rubin 及下一代 Feynman 平台功耗预计超 2000W，现有散热方案不足，英伟达要求供应商研发单价为现有 3 至 5 倍的 MLCP 液冷技术。
- **高算力芯片和 AI 服务器推动液冷技术持续迭代。**大算力需求正推动芯片功耗持续攀升，以 NVIDIA 为代表的主流厂商产品持续升级。NVIDIA AI 芯片功率从 A100 的 400W 逐步提升至 GB200 的 1200W、GB300 的 1400W，而与之匹配的算力性能实现跨越式增长，如 GB200 的 FP16 算力达 5 PFLOPS、FP4 算力达 20 PFLOPS，NVLink 带宽提升至 3.6TB/s。这种算力与功耗的同步增长在服务器端形成叠加效应，英伟达旗舰 DGXB 200 机箱集成 8 颗 B200 GPU 后总功耗达 14.3kW，机架层面需额外预留 60kW 功率与散热容量以保障稳定运行。
- **MLCP 作为液冷迭代升级的方向。**液冷（Liquid Cooling）是通过冷却介质流经设备散热器吸收并带走热量以降低电子设备温度的散热方式，相较于传统风冷，其降温效率更优且能助力提升设备性能、延长使用寿命，尤其当机柜密度超过 20kW 时优势显著；根据冷却液与服务器的接触换热方式，液冷可分为直接液冷（含浸没式、喷淋式）与间接液冷（冷板式）。作为液冷技术迭代升级的关键形态，MLCP 是适配服务器、AI 芯片等高性能计算设备的核心散热组件，其通过精密加工在芯片或封装结构上集成 10-1000 微米流道，实现冷却液与热源零距离接触以缩短传热路径，相较于传统液冷板，MLCP 支持的 TDP 功耗更高、热阻更小，能更好适配高功率密度器件散热需求，但成本更高，且存在制造复杂、良率挑战的限制。
- **液冷行业趋势潜在受益企业：英维克、高澜股份、思泉新材。**英维克是行业内少数具备全链条液冷解决方案的企业，2021 年率先推出 Coolinside 全链条液冷方案，实现从冷板到冷源的“端到端”产品覆盖，2024 年相关产品通过英特尔验证，截至 2025 年 3 月液冷链条累计交付 1.2GW 且零漏液；高澜股份作为国内专业热管理供应商，数据中心液冷领域有冷板、浸没式双方案及一站式服务能力，产品 PUE≤1.1 且已批量供货；思泉新材积极研发液冷技术，聚焦多行业，构建含液冷板的完整热管理产品体系，可提供定制化解决方案。
- **投资建议：**我们看好液冷技术在高算力芯片与服务器发展中的带动作用，建议关注行业内潜在供应商包括英维克、高澜股份、思泉新材。他们均具备液冷技术储备和开拓迭代的能力。
- **风险提示：**1) 国际贸易摩擦加剧 2) 下游需求不及预期 3) 技术升级进度滞后

目录

1. NVIDIA 推动供应商加速 MLCP 产业化落地	4
1.1 高算力芯片和 AI 服务器推动液冷技术持续迭代	4
1.2 MLCP 作为液冷迭代升级的方向	5
1.3 液冷技术潜在供应商	7
2. 全球产业动态	9
2.1 DeepSeek-R1 登入《Nature》杂志	9
2.2 NVIDIA 违反反垄断法	9
2.3 华为发布“4+10+N”中小企业智能化方案	9
2.4 AMD 发布 EPYC 嵌入式 4005 系列处理器	10
2.5 联发科与台积电共同推出 2nm Soc	10
3. 本周市场回顾	12
3.1 SW 一级行业涨跌幅一览	12
3.2 SW 电子三级行业市场表现	13
3.3 SW 电子行业个股情况	13
3.4 SW 科技行业其他市场表现	14
4. 风险提示	15

图表目录

图表 1：NVIDIA 芯片算力持续提升.....	4
图表 2：NVIDIA 各芯片 TPD 功耗梳理.....	4
图表 3：芯片等电子元件故障有 55%源于高温过热.....	5
图表 4：当机柜密度超过 20kW 时，液冷相较于风冷散热更具高效.....	6
图表 5：冷板式、喷淋式与浸没式技术比较.....	6
图表 6：MLCP 与传统液冷板对比.....	7
图表 7：英维克、高澜股份、思泉新材厂商纷纷加速液冷技术研发.....	7
图表 8：本周 SW 一级行业涨跌幅一览.....	12
图表 9：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览.....	13
图表 10：SW 电子个股本周涨跌幅前十.....	14
图表 11：SW 电子个股本周涨跌幅后十.....	14
图表 12：本周费城半导体指数.....	14
图表 13：本周恒生科技指数.....	14
图表 14：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览.....	15

1. NVIDIA 推动供应商加速 MLCP 产业化落地

2025 年 9 月 15 日，据中国台湾《经济日报》报道，由于 AI 新平台 Rubin 以及下一代 Feynman 平台的功耗预计将高达 2000W 以上，现有的散热方案已无法满足需求。在此情形下，NVIDIA 要求供应商研发全新的 MLCP 液冷技术，该技术的单价将达到现有散热方案的 3 至 5 倍。

1.1 高算力芯片和 AI 服务器推动液冷技术持续迭代

大算力需求正推动芯片功耗上升。在芯片层面，以 NVIDIA 为代表的主流厂商推出的产品，在算力提升的同时，功耗也快速增长：NVIDIA AI 芯片功率从 A100 的 400W 增加至 GB200 的 1200W、GB300 的 1400W。

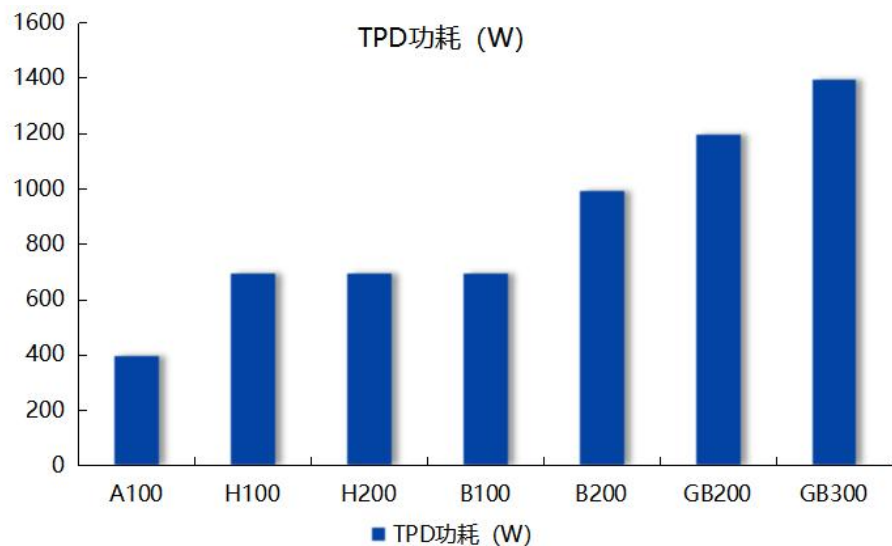
图表 1：NVIDIA 芯片算力持续提升

算力类型	A100	H100	H200	B100	B200	GB200
FP16 (FLOPS)	312T	1P	1P	1.75P	2.25P	5P
FP8 (FLOPS)	-	2P	2P	3.5P	4.5P	10P
INT8 (OPS)	624T	2P	2P	3.5P	4.5P	10P
FP6 (FLOPS)	-	-	-	3.5P	4.5P	10P
FP4 (FLOPS)	-	-	-	7P	9P	20P
NVLink 带宽	600GB/s	900GB/s	900GB/s	1.8TB/s	1.8TB/s	3.6TB/s

资料来源：NVIDIA 官网，eefocus，爱建证券研究所

注：仅列举 NVIDIA 代表产品

图表 2：NVIDIA 各芯片 TPD 功耗梳理



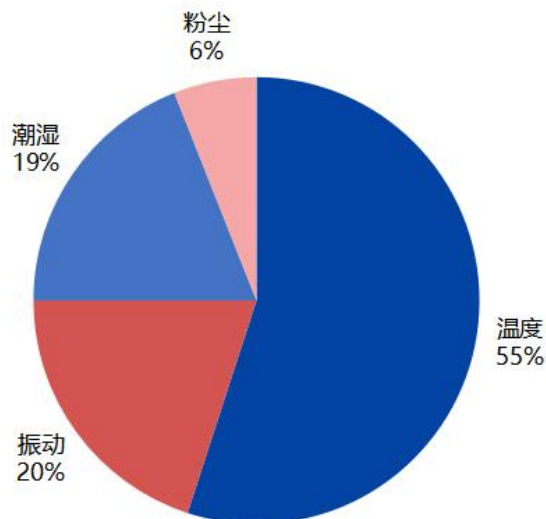
资料来源：VERTIV，爱建证券研究所

AI 服务器多采用 CPU+GPU、CPU+ASIC 等异构架构，核心搭载高功耗高性能的算力芯片。以 NVIDIA 旗舰方案为例，其 DGX B200 机箱集成 8 颗 B200 GPU（支撑超大规模模型训练需求），据官方数据，该机箱总功耗约 14.3kW；为保障设备稳定运行，机架层面需额外预留约 60kW 的功率与散热容量。

高温会直接影响 AI 服务器中芯片等核心电子元件的使用寿命，进而诱发服务器故障。

从故障成因来看, 电子元件故障有 55%源于高温过热: 服务器核心的半导体元器件(如 GPU 等算力芯片) 对温度敏感, 温度每升高 10°C, 反向漏电流便会增加 1 倍, 显著加速元件损耗。

图表 3: 芯片等电子元件故障有 55%源于高温过热



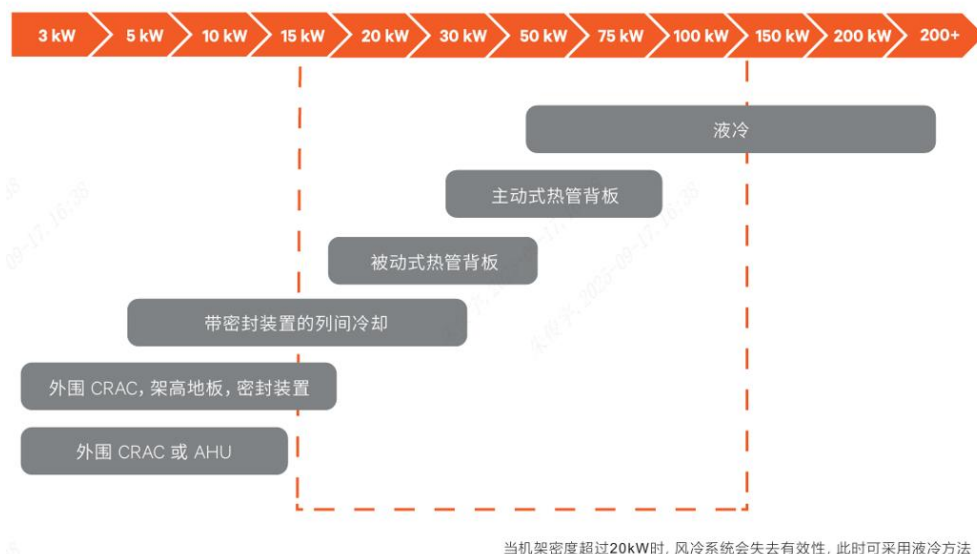
资料来源: Management White Paper of Energy-saving Liquid Data Center, 爱建证券研究所

因此, 我们认为: 在高算力芯片与 AI 服务器持续迭代、功耗不断攀升的背景下, 液冷技术的持续开发对于二者的长期发展至关重要。

1.2 MLCP 作为液冷迭代升级的方向

液冷 (Liquid Cooling) 是电子设备的一种散热方式, 通过冷却介质流过设备散热器, 吸收并带走设备产生的热量, 进而降低设备温度。相较于传统风冷, 它能更有效地为设备降温, 助力提升设备性能与延长使用寿命; 当机柜密度超过 20kW 时, 液冷的散热效率更具显著优势。

图表 4：当机柜密度超过 20kW 时，液冷相较于风冷散热更具高效



资料来源：VERTIV，爱建证券研究所

根据冷却液和服务器接触换热方式的不同，液冷技术可分为直接液冷和间接液冷，其中浸没式与喷淋式属于直接液冷，而冷板式属于间接液冷。

冷板式液冷技术在可维护性、空间利用率、兼容性、安装简捷方面具有较强的应用优势；但在成本方面，由于其单独定制冷板装置，技术应用的成本相对较高。而喷淋式液冷技术则通过改造旧式的服务器和机柜的形式，大幅度减少了数据中心基础设施的建设成本。浸没式技术与其他两种技术相比，虽然器件的可维护性和兼容性较差，但空间利用率与可循环方面具有较好的表现，降低数据中心的能耗。

图表 5：冷板式、喷淋式与浸没式技术比较

比较项目	冷板式	喷淋式	浸没式
成本	冷板要求的规格多，大多需要单独定制，成本较高	通过改造旧式服务器和机柜，增加必须的装置，成本较小	冷却液用量较多，与冷板式相比成本居中
可维护性	优秀	中等	较差
空间利用率	较高	最高	中等
兼容性	未与主板和芯片模块进行直接的接触，材料兼容性较强	直接接触，材料兼容性较差	直接接触，材料兼容性较差
安装简捷程度	不改变服务器主板原有的形态，保留现有服务器主板，安装便捷	不改变服务器主板原有的形态，安装便捷	改变服务器主板原有结构，需重新安装
可循环	采用双路环状循环对冷冻液实现二次利用，降低运营成本	采用循环泵，实现资源的再利用，降低运营成本	通过室外冷却装置进行循环，降低运营成本

资料来源：BLUEOCEAN，爱建证券研究所

MLCP（微通道水冷板）是液冷技术迭代升级的关键形态。MLCP 作为适配服务器、AI 芯片等高性能计算设备的核心散热组件，其核心设计逻辑在于通过精密加工在芯片或封装结构上集成 10-1000 微米的流道，直接实现冷却液与热源的零距离接触，大幅缩短传热路径。

相较于传统液冷板，MLCP 支持的 TDP 功耗更高（>2000W），能更好适配高功率密度器件的散热需求，且热阻更小（<0.05℃·cm²/W），但同时它的成本也相对更高。

图表 6：MLCP 与传统液冷板对比

特性	传统液冷板	MLCP
最大支持 TDP	500W-1000W	>2000W
典型热阻	0.10—0.20°C·cm²/W	<0.05°C·cm²/W
相对成本	2x ~ 4x	6x ~ 10x
主要限制	接触热阻较高	制造复杂，良率挑战

资料来源：艾邦笔电论坛，爱建证券研究所

1.3 液冷技术潜在供应商

图表 7：英维克、高澜股份、思泉新材厂商纷纷加速液冷技术研发

特性	传统液冷板
英维克	2021 年英维克率先推出 Coolinside 全链条液冷方案； 2024 年 9 月，公司在英特尔中国数据中心液冷创新加速计划中，该方案包含的 BHS-AP 平台 CPU 液冷冷板、UQD 快速接头、Manifold 机柜级分水器、液冷 CDU 等产品通过英特尔验证； 截至 2025 年 3 月，公司液冷链条累计交付量已达 1.2GW。
高澜股份	公司已形成冷板液冷、浸没液冷两大数据中心热管理解决方案，具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合服务能力；其数据中心液冷产品可将 PUE 值控制在 1.1 以内，且当前已具备批量供货能力。
思泉新材	公司已构建起涵盖石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热垫片、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板的完整热管理产品体系。

资料来源：各公司公告，爱建证券研究所

英维克专注全链条液冷技术研发。英维克为云计算数据中心、算力设备、通信网络、电力电网、储能系统等领域提供散热解决方案，主要产品涵盖机房温控节能产品、机柜温控节能产品等。2024 年，公司机房温控节能设备营收达 24.4 亿元（占主营业务 53.2%），户外机柜温控节能设备营收 17.2 亿元（占主营业务 37.4%），核心温控业务对营收支撑作用显著。

作为行业内少数具备全链条液冷解决方案的企业，英维克 2021 年率先推出 Coolinside 全链条液冷方案，形成从冷板、快速接头、Manifold、CDU、机柜，到 SoluKing 长效液冷工质、管路、冷源的“端到端”产品覆盖。2024 年 9 月，在英特尔中国数据中心液冷创新加速计划中，该方案包含的 BHS-AP 平台 CPU 液冷冷板、UQD 快速接头、Manifold 机柜级分水器、液冷 CDU 等产品通过英特尔验证；截至 2025 年 3 月，公司液冷链条累计交付量已达 1.2GW，且各项目运行期间保持零漏液记录，充分印证了 Coolinside 液冷方案的可靠性与稳定性。

高澜股份积极开拓液冷技术研发。高澜股份作为国内专业热管理供应商，其主要产品涵盖直流输电换流阀纯水冷却设备、柔性交流输配电晶闸管阀纯水冷却设备、大功率电气传动变频器纯水冷却设备，以及数据中心液冷产品、储能液冷产品等，有效覆盖多领域热管理需求。

在数据中心液冷领域，公司已形成冷板液冷、浸没液冷两大数据中心热管理解决方案，具备从散热架构设计、设备集成到系统调试与运维的一站式综合服务能力；其数据中心液冷产品可将 PUE 值控制在 1.1 以内，当前已具备批量供货能力。在储能液冷领域，公司布局同样深入，已储备大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品、锂电池单柜储能液冷产品等相关技术与解决方案，相关产品目前也已实现批量供货。

思泉新材积极投入液冷技术研发与创新。思泉新材是一家以热管理材料为核心的多元化功能性材料提供商，所属行业为“C397 电子器件制造”，同时也是行业领先的散热解决方案提供商。公司聚焦消费电子（含 3C 电子）、汽车电子、光伏储能、AIoT、数据中心、新能源、高端装备等行业领域，已构建起涵盖石墨散热膜、石墨散热片、散热风扇、均热板、导热垫片、导热凝胶、热管、散热模组、液冷板的完整热管理产品体系——既包含石墨散热片、导热垫片等导热界面材料，也覆盖均热板、热管、散热模组、液冷板等散热器件，能够针对电子产品的多样化散热需求，为客户提供定制化、系统化的全面散热解决方案。

公司主要服务于北美大客户、小米、vivo、三星等国内外科技和消费电子行业领先客户，依托上述产品与方案，可助力上述行业在极端工况下突破性能瓶颈、实现跨越式发展。与此同时，公司持续推进石墨膜扩产项目、液冷产品生产项目、石墨烯与合成石墨垂直取向热界面材料项目、高性能导热散热产品建设项目（二期）等重点项目建设，以加快培育新的业务增长点，进一步巩固在热管理领域的竞争优势。

2. 全球产业动态

2.1 DeepSeek-R1 登入《Nature》杂志

2025 年 9 月 17 日, DeepSeek 创始人梁文锋以通讯作者身份, 将推理模型 DeepSeek-R1 的研究论文发表于《自然》杂志封面。这是首个通过完整同行评审的主流大语言模型, 标志着国产 AI 研究跻身全球前沿。

该模型的核心突破在于: 摒弃大量人工标注的思维链数据, 通过强化学习让模型自主形成推理能力。具体而言, 研究团队先基于 DeepSeek-V3 Base 构建出 R1-Zero, 以“最终答案正确性”为奖励引导模型生成逻辑回答; 再通过多阶段训练, 结合监督微调与拒绝采样, 最终打造出兼具强推理性能与人类偏好的 DeepSeek-R1。

本次论文不仅补充了关键技术细节, 还首次披露了训练成本:

数据层面: DeepSeek-V3 Base 的预训练数据源自互联网, 虽可能包含少量 GPT-4 生成内容, 但无任何刻意蒸馏行为; 为避免基准测试成绩失真, 团队还对数据进行大规模清理, 仅数学领域就剔除了约 600 万条潜在污染样本。

安全性层面: DeepSeek-R1 引入外部风险控制机制, 并通过 DeepSeek-V3 进行实时审查, 其安全性表现优于 Claude-3.7-Sonnet、GPT-4o 等主流模型。

成本层面: R1 的训练成本仅 29.4 万美元 (不含其基础模型 DeepSeek-V3 Base 的研发投入)。

2.2 NVIDIA 违反反垄断法

2025 年 9 月 15 日, 国家市场监督管理总局发布公告称, 经初步调查, NVIDIA 公司违反《中华人民共和国反垄断法》和《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》, 市场监管总局依法决定对其实施进一步调查。

早在 2024 年 12 月 9 日, 国家市场监督管理总局就曾发布公告称, 近期因 NVIDIA 公司涉嫌违反《中华人民共和国反垄断法》, 及违反《市场监管总局关于附加限制性条件批准英伟达公司收购迈络思科技有限公司股权案反垄断审查决定的公告》(市场监管总局公告〔2020〕第 16 号), 市场监管总局已依法对英伟达公司开展立案调查。

经过 9 个多月的调查, 从国家市场监督管理总局最新发布的公告来看, 已经初步确认了 NVIDIA 违反中国的“反垄断法”以及此前市场监管总局有条件批准英伟达收购迈络思交易的相关协议。

2.3 华为发布“4+10+N”中小企业智能化方案

2025 年 9 月 17 日, 华为管理层在“华为坤灵, 助力中小企业跃升智能化”主题秋季新品发布会上, 发布了“4+10+N”中小企业智能化方案, 以一站式场景化方案助力中小企业打通迈向智能世界的“最后一公里”; 同时, 华为还面向中国分销伙伴发布“百&万计划”, 计划发展 100 家分销钻石伙伴、10000 家精英工程商, 全面助力中小企业智能化

跃升。

其中，“4”聚焦企业生产经营中的四大核心场景——智能办公、智能商业、智能教育、智能医疗；“10”指 10 大一站式场景化方案，涵盖中小企业办公、智能酒店、数字诊疗平台、智能互动教室等；“N”则是围绕四大场景定义的系列化明星产品，本次华为共发布 26 款针对分销市场的明星产品，包括集成路由、交换、Wi-Fi7、VPN 等功能的企业级无线路由器 AR180，以及融合 AI 会议、智能音幕、智能应用的 IdeaHub 等，为四大场景提供极简融合、交互智能、全域安全的全系列产品支撑。

在方案落地层面，方案开发上，通过产品智能化、方案预集成预验证、多产品组合协同，实现如“搭积木”般简单灵活的方案组合；销售赋能上，通过一站式资料获取、方案体验、场景化配单，降低工程商与客户在产品选型、方案设计上的复杂度；交付服务上，实现统一安装、统一网管、统一客服，既让客户能快速获取智能化技术，也让工程商交付无后顾之忧。

2.4 AMD 发布 EPYC 嵌入式 4005 系列处理器

美国时间 2025 年 9 月 16 日，AMD 正式推出 EPYC（霄龙）嵌入式 4005 系列处理器。该系列基于先进的 Zen5 微架构打造，并全面支持 AM5 平台，旨在为嵌入式场景提供高性能与高可靠性的计算解决方案。

在产品规格方面，EPYC 嵌入式 4005 系列共提供六款 SKU，核数覆盖 6 核至 16 核，满足不同场景的性能需求。其中，16 核型号特别搭载业界领先的 3DV-Cache 技术，将 L3 缓存容量提升至 128MB，可显著优化存储器密集型及延迟敏感型工作负载的运行表现；标准版本则配备 64MB L3 缓存，频率范围从 3.0GHz 基频延伸至 5.7GHz 最高加速频率，兼顾基础算力与峰值性能。

存储器配置上，该系列处理器支持双通道 DDR 5 ECC 存储器，最高速率可达 5600MT/s，最大支持 192GB 存储容量；同时集成两级 DRAM 错误更正码、PCIe 错误检测等 RAS（可靠性、可用性及可维护性）功能，能有效保障系统长时间稳定运行，适配对稳定性要求严苛的嵌入式场景。

此外，处理器配备最多 28 条 PCIe Gen 5 通道及多种安全技术，包括 AMD Secure Processor 及 TPM 2.0，透过安全启动和加密功能加强防护。TDP 跨 65W 至 170W 不等，满足不同功耗需求。

2.5 联发科与台积电共同推出 2nm Soc

2025 年 9 月 16 日，联发科正式宣布，其首款采用台积电 2 nm 制程的旗舰系统单晶片（SoC）已成功完成设计定案（tape out），成为全球首批落地该先进制程的企业之一。根据规划，这款晶片预计于 2026 年底启动量产，并在同年末正式进入市场。

此次合作不仅标志着联发科与台积电在旗舰移动平台、计算、车用及数据中心等核心领域的合作持续深化，更进一步巩固了双方的战略伙伴关系。联发科方面表示，2nm 制程技术的导入，将显著提升产品的运算效能与能源效率，为多元应用场景提供更强大的技术支撑。

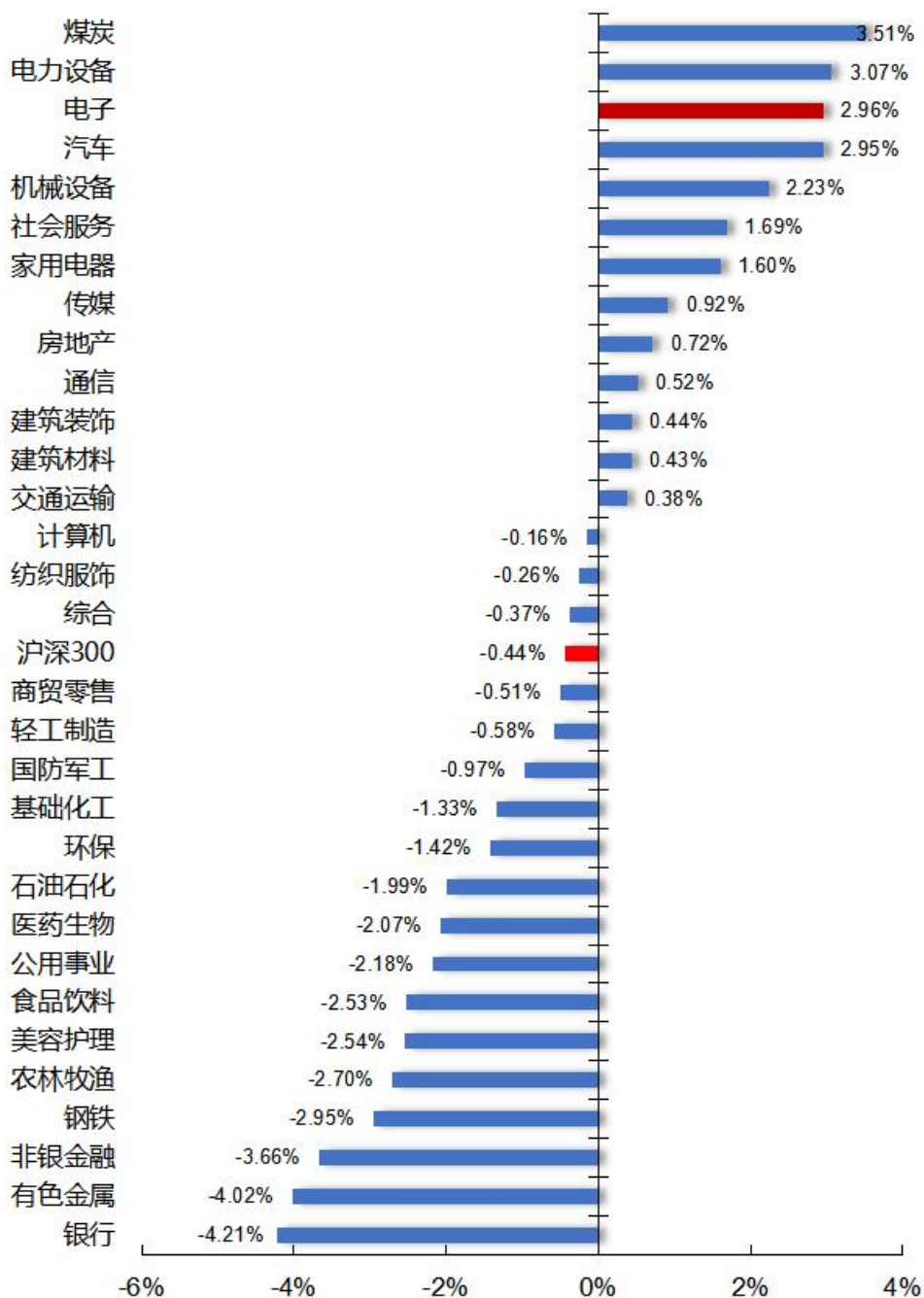
从技术特性来看，台积电 2nm 制程采用了先进的奈米片（Nano sheet）电晶体架构：相较于现行的 N3E 节点，其逻辑密度提升约 1.2 倍；在相同功耗条件下，效能可提升高达 18%；而在保持相同运算速度时，功耗能降低约 36%。这一技术优势对行动设备的续航能力优化、高运算平台的散热压力缓解均具有关键意义。

3. 本周市场回顾

3.1 SW 一级行业涨跌幅一览

本周 SW 电子行业指数(+2.96%)，涨跌幅排名 3/31 位，沪深 300 指数(-0.44%)。SW 一级行业指数涨跌幅前五分别为：煤炭(+3.51%)，电力设备(+3.07%)，电子(+2.96%)，汽车(+2.95%)，机械设备(+2.23%)，涨跌幅后五分别为：银行(-4.21%)，有色金属(-4.02%)，非银金融(-3.66%)，钢铁(-2.95%)，农林牧渔(-2.70%)。

图表 8：本周 SW 一级行业涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.2 SW 电子三级行业市场表现

本周 SW 电子三级行业指数涨跌幅前三分别是：半导体设备（+9.98%），光学元件（+9.08%），集成电路制造（+5.63%）；涨跌幅后三分别是：数字芯片设计（-0.18%），面板（+0.22%），其他电子Ⅲ（+0.74%）。

图表 9：本周 SW 电子三级行业涨跌幅一览



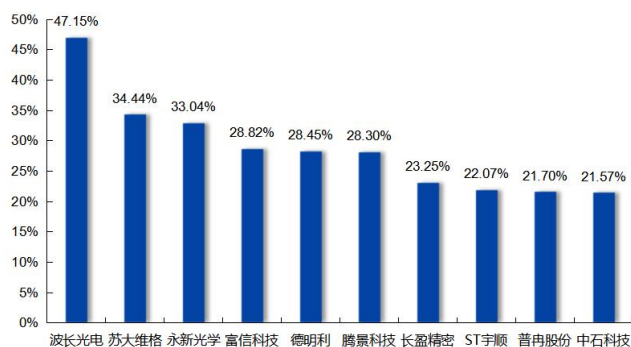
资料来源：iFinD，爱建证券研究所

3.3 SW 电子行业个股情况

本周 SW 电子行业涨跌幅排名前十的股票分别是：波长光电（+47.15%），苏大维格（+34.44%），永新光学（+33.04%），富信科技（+28.82%），德明利（+28.45%），腾景科技（+28.30%），长盈精密（+23.25%），ST 宇顺（+22.07%），普冉股份（+21.70%），中石科技（+21.57%）。

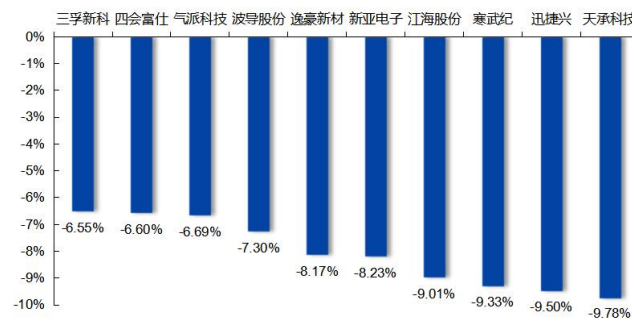
涨跌幅排名后十的股票分别是：天承科技（-9.78%），迅捷兴（-9.50%），寒武纪（-9.33%），江海股份（-9.01%），新亚电子（-8.23%），逸豪新材（-8.17%），波导股份（-7.30%），气派科技（-6.69%），四会富仕（-6.60%），三孚新科（-6.55%）。

图表 10: SW 电子个股本周涨跌幅前十



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

图表 11: SW 电子个股本周涨跌幅后十

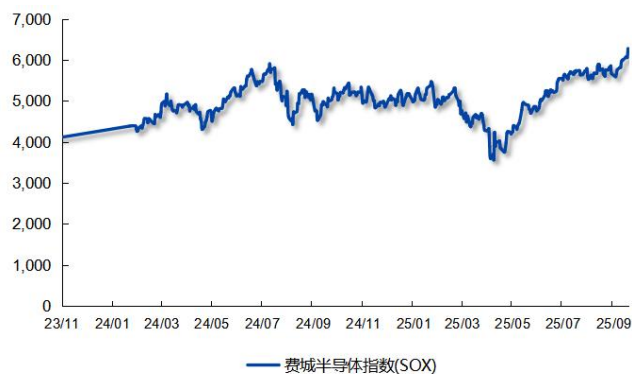


资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

3.4 SW 科技行业其他市场表现

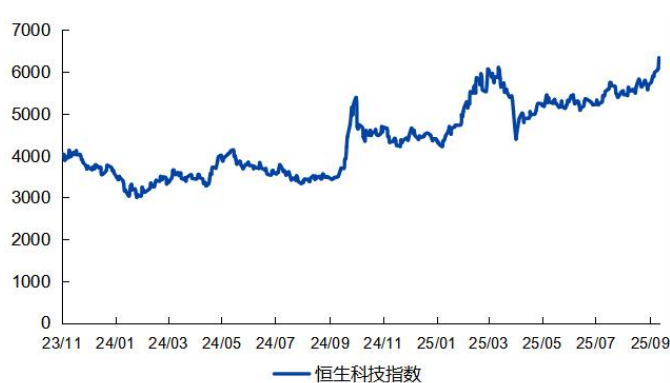
费城半导体指数 (SOX) 本周涨跌幅为+3.84%; 恒生科技指数本周涨跌幅为+5.09%。

图表 12: 本周费城半导体指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

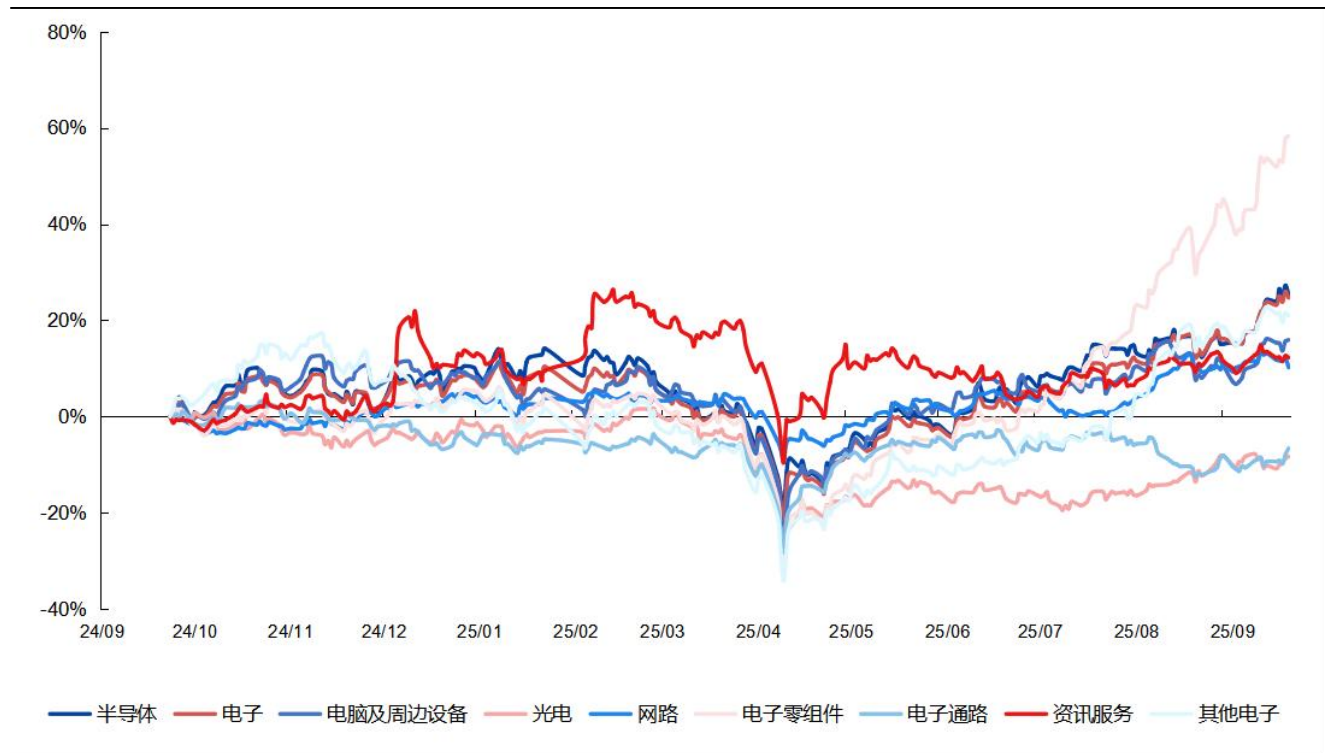
图表 13: 本周恒生科技指数



资料来源: iFinD, 爱建证券研究所

中国台湾电子指数各板块本周涨跌幅分别是: 半导体 (+0.85%), 电子 (+0.69%), 电脑及周边设备 (-0.19%), 光电 (+2.07%), 网路 (-2.57%), 电子零组件 (+3.06%), 电子通路 (+3.05%), 资讯服务 (-1.06%), 其他电子 (-1.48%)。

图表 14：本周中国台湾电子指数涨跌幅一览



资料来源：iFinD，爱建证券研究所

4. 风险提示

- 1) 国际贸易摩擦加剧
- 2) 下游需求不及预期
- 3) 技术升级进度滞后

爱建证券有限责任公司

上海市浦东新区前滩大道 199 弄 5 号

电话: 021-32229888

传真: 021-68728700

服务热线: 956021

邮政编码: 200124

邮箱: ajzq@ajzq.com

网址: <http://www.ajzq.com>

评级说明

投资建议的评级标准

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后 6 个月内的相对市场表现，也即以报告发布日后的 6 个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A 股市场：沪深 300 指数（000300.SH）；新三板市场：三板成指（899001.CSI）（针对协议转让标的）或三板做市指数（899002.CSI）（针对做市转让标的）；北交所市场：北证 50 指数（899050.BJ）；香港市场：恒生指数（HIS.HI）；美国市场：标普 500 指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）。

股票评级

买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 15%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5% ~ 15% 之间
持有	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 -5% ~ 5% 之间
卖出	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于 -5%

行业评级

强于大市	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
弱于大市	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告采用信息和数据来自公开、合规渠道，所表述的观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的独立看法。研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测、数量化方法、或行业比较分析所得出的结论，但使用以上信息和分析方法可能存在局限性，请谨慎参考。

法律主体声明

本报告由爱建证券有限责任公司（以下统称为“爱建证券”）证券研究所制作，爱建证券具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管。

本报告是机密的，仅供我们的签约客户使用，爱建证券不因收件人收到本报告而视其为爱建证券的签约客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但爱建证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供签约客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，爱建证券及其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测后续可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，爱建证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

版权声明

本报告版权归爱建证券所有，未经爱建证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。版权所有，违者必究。